

DWG. NO. SD-53309-013

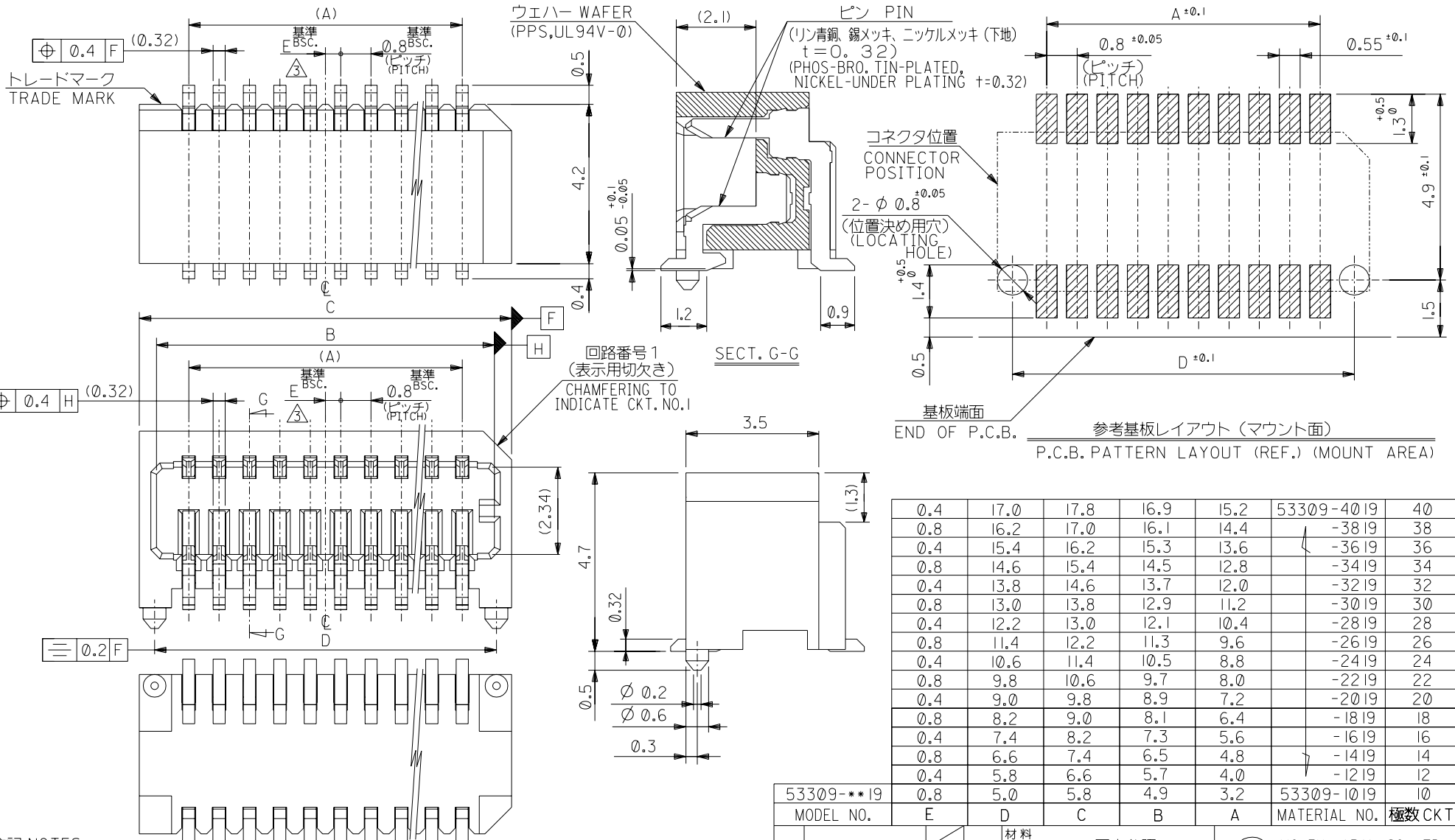
E

D

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A



注記 NOTES

1. 嵌合相手：52465,52588シリーズ
MATE WITH : 52465,52588 SERIES
2. ウェハの C から隣接するピンの C 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM C OF WAFER TO C OF ADJACENT PINS.
3. 本製品は 53309-***17 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-***17.

角度 ANGLE	±3°
30 以上 OVER	+0.3
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25
10 未満 UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

53309-***19						
MODEL NO.	E	D	C	B	A	MATERIAL NO. 極数 CKT.

0.4	17.0	17.8	16.9	15.2	53309-4019	40
0.8	16.2	17.0	16.1	14.4	-3819	38
0.4	15.4	16.2	15.3	13.6	-3619	36
0.8	14.6	15.4	14.5	12.8	-3419	34
0.4	13.8	14.6	13.7	12.0	-3219	32
0.8	13.0	13.8	12.9	11.2	-3019	30
0.4	12.2	13.0	12.1	10.4	-2819	28
0.8	11.4	12.2	11.3	9.6	-2619	26
0.4	10.6	11.4	10.5	8.8	-2419	24
0.8	9.8	10.6	9.7	8.0	-2219	22
0.4	9.0	9.8	8.9	7.2	-2019	20
0.8	8.2	9.0	8.1	6.4	-1819	18
0.4	7.4	8.2	7.3	5.6	-1619	16
0.8	6.6	7.4	6.5	4.8	-1419	14
0.4	5.8	6.6	5.7	4.0	-1219	12
0.8	5.0	5.8	4.9	3.2	53309-1019	10

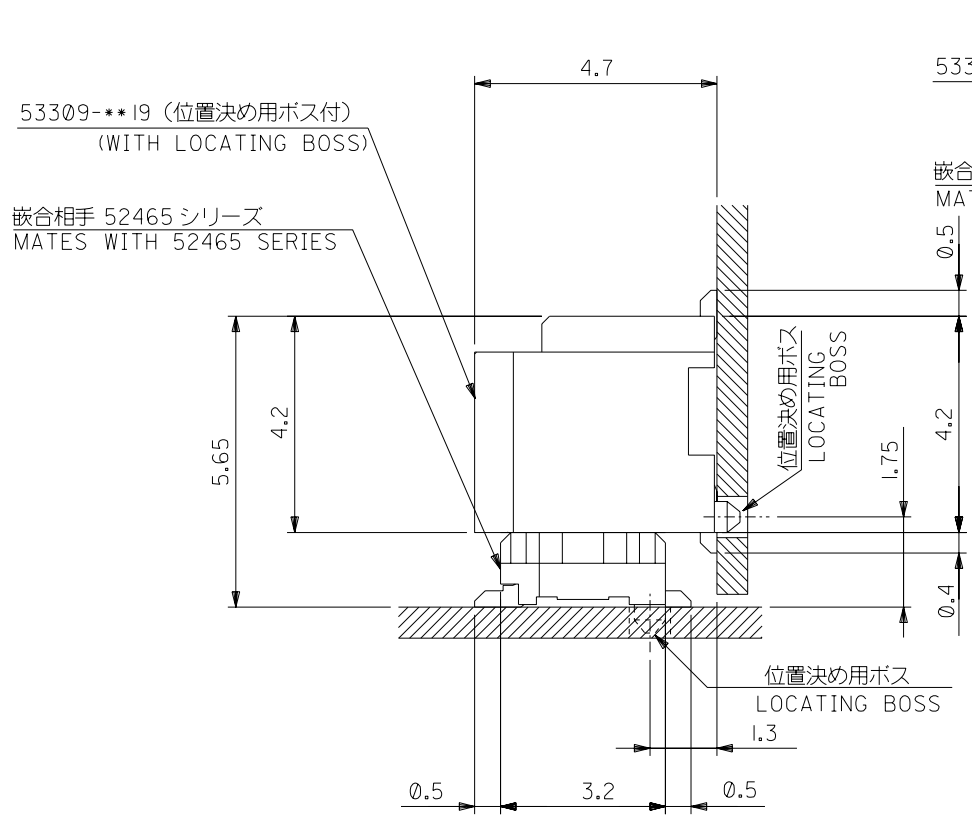
材料 MATERIAL 図中参照 SEE DRAWING

仕上げ FINISH #
適用電線範囲 WIRE RANGE #
被覆外径 INS. RANGE #
DRAWN BY 04/03/10 H.KAWABATA
CHK'D BY 04/03/10 K.TOJO
APP'D BY 04/03/10 M.SASAO
DATE 04/03/10

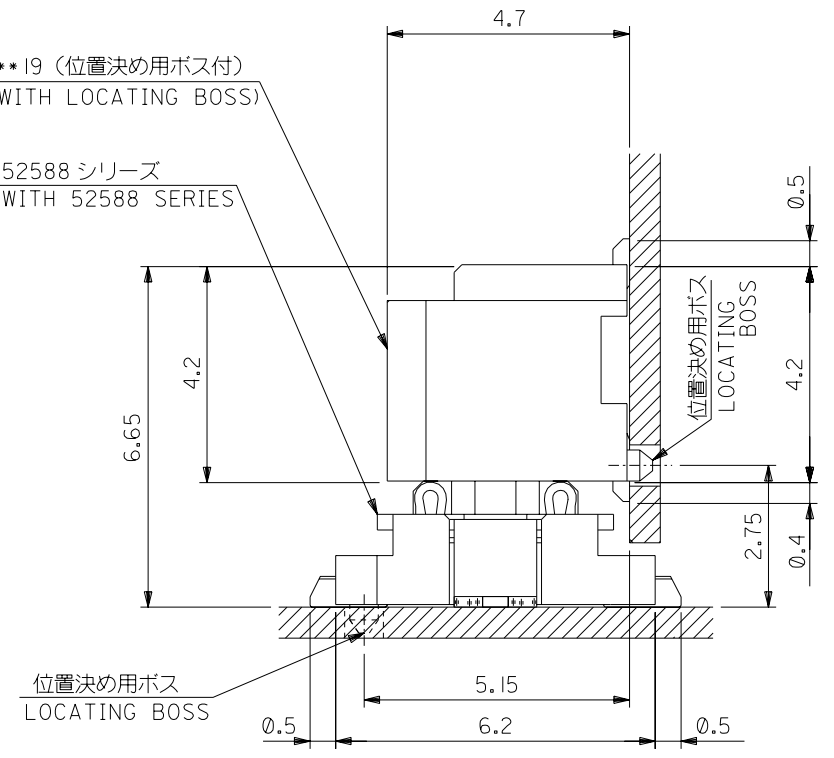
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A SMT (WITH BOSS) -LEAD FREE-
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV 0
SD-53309-013

DWG. NO. SD-53309-013
 DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)



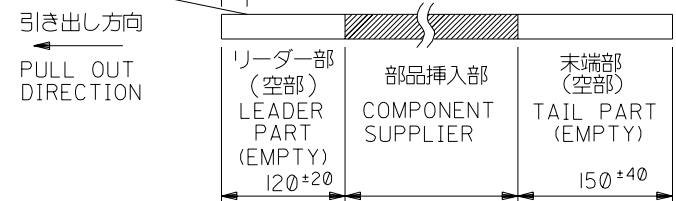
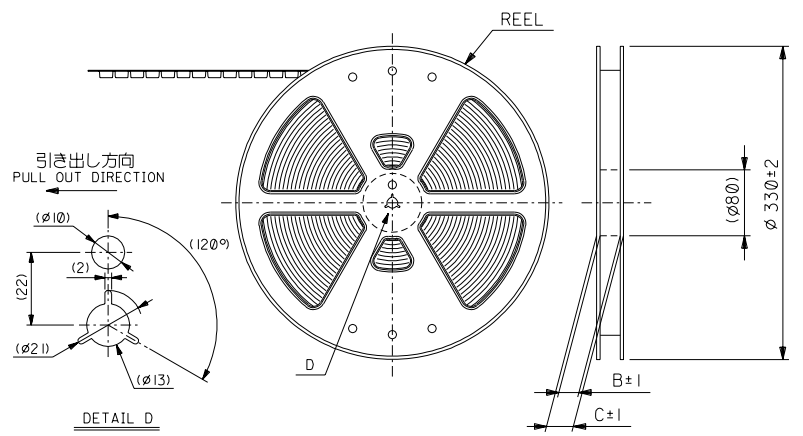
嵌合状態図 (参考)
MATED DRAWING(REF.)

				MODEL NO. 53309-**19	
				材料 MATERIAL	
				SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	
				仕上げ FINISH #	
				適用電線範囲 WIRE RANGE #	
				被覆外径 INS. RANGE #	
				DRAWN BY '04/03/10 H.KAWABATA	
				CHK'D BY '04/03/10 K.TOJO	
				DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV 0	
				SD-53309-013	

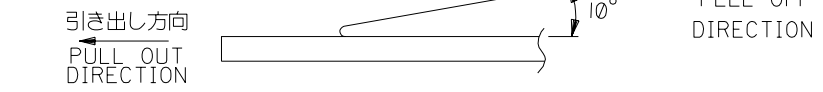
角度 ANGLE	+30				
30 以上 OVER	+0.3				
10 以上 OVER 30 未満 UNDER	+0.25				
10 未満 UNDER	+0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					
記号 LTR	①	新規作成 RELEASED (2004-3005)	DR. CHK.	日付 DATE	'04/03/10
変更内容 REVISION RECORD					
APP'D BY	M.SASAO	尺度 SCALE			

注記 NOTES

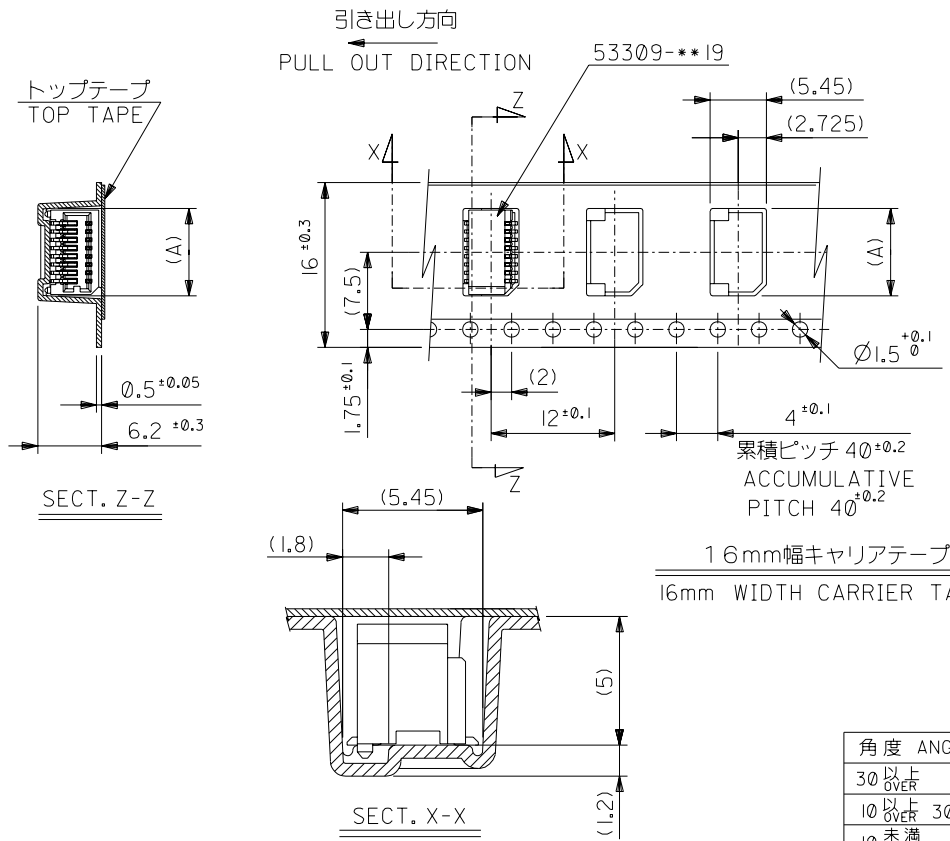
1. 梱包数量：1000個/リール NUMBER OF CONNECTORS:1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH



3. トップテープの剥離強度：(剥離方向は下図参照)
0.1~1.3N {10~130gf} 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
0.1~1.3N {10~130gf} (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



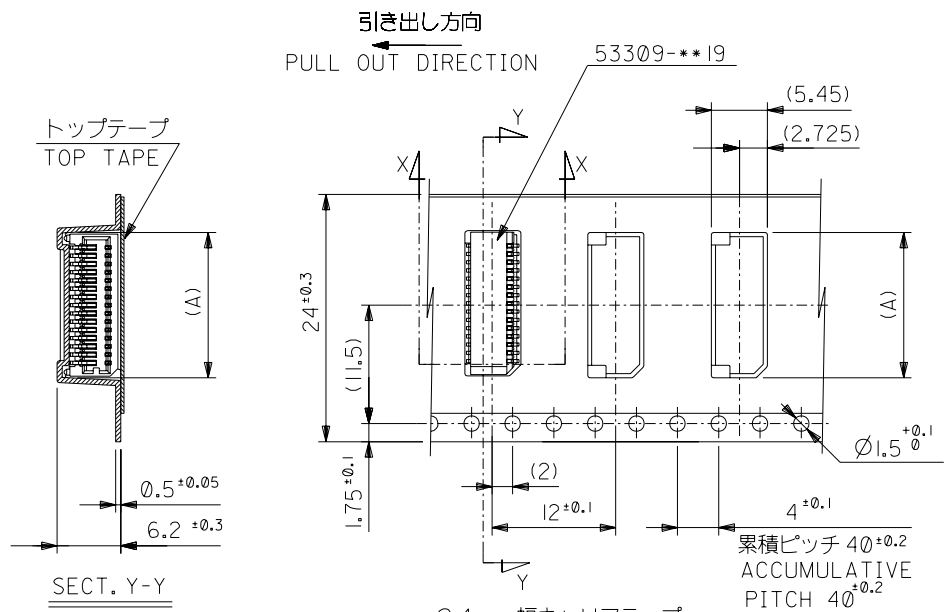
5. 材料(MATERIAL)
キャリアテープ(CARRIER TAPE)：ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOPTAPE)：PET, PE, PEF
リール(REEL)：ポリスチレン(PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
6. 本製品は53309-**-**90の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 53309-**-**90.



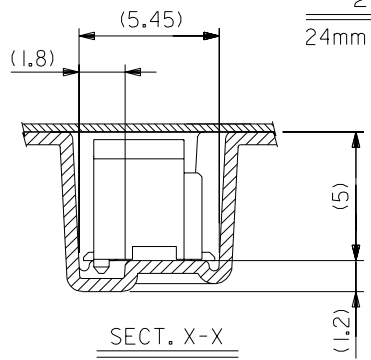
53309-**71 MODEL NO.	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	9.3	53309-1871	18
					8.5	53309-1671	16
					7.7	53309-1471	14
					6.9	53309-1271	12
					6.1	53309-1071	10
					MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT	

角度 ANGLE		±3°				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30以上 OVER	±0.5					仕上げ FINISH	—	
10以上 30未満 UNDER	±0.25					適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称
未満 10 UNDER	±0.2					被覆外径 INS. RANGE	—	0.8 BtB Conn Wafer Assy RA SMT With Boss Embstp Pkg -LEAD FREE-
一般公差 GENERAL TOLERANCES	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	尺度 SCALE	DRAWN BY '04/03/10 H.KAWABATA	CHK'D BY '04/03/10 K.TOJO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)
						APPD BY '04/03/10 M.SASAO	尺度 SCALE	REV

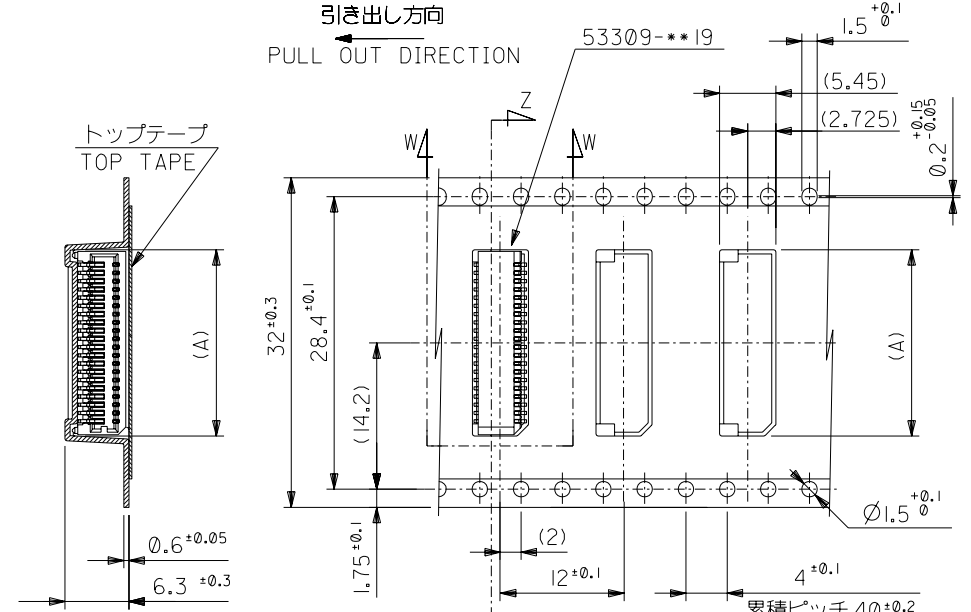
DWG. NO.
SD-53309-014



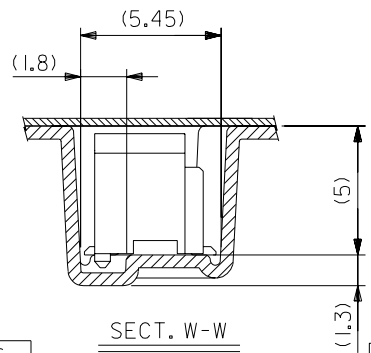
24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT. X-X



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE



SECT. W-W

24	29.4	25.4	16.5	53309-3671	36
			15.7	53309-3471	34
			14.9	53309-3271	32
			14.1	53309-3071	30
			13.3	53309-2871	28
			12.5	53309-2671	26
			11.7	53309-2471	24
			10.9	53309-2271	22
			10.1	53309-2071	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	C	B	(A)	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

53309-***71	キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	32	37.4	33.4	18.1	53309-4071	40
MODEL NO.			C	B	(A)	53309-3871	38
						MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

角度 ANGLE	±3°			材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER	+0.5			仕上げ FINISH	—		
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25			適用電線範囲 WIRE RANGE	—	TITLE 名称	0.8 B+B Conn Wafer Assy
10°未満 UNDER	+0.2			被覆外径 INS. RANGE	—	RA SMT With Boss	Embstp Pkg
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	-LEAD FREE-	
		①	新規作成 (2004-3005) RELEASED	DR. CHK.	04/03/10	DWG. NO. (SHEET 2 OF 2)	REV
				H.KAWABATA	K.TOJO	SD-53309-014	0
				M.SASAO			